

SMT 用ワークに対する仕様

I 実装部品の仕様

部品サイズ	0603角チップ～100×90mm 大型コネクタ
梱包形態	・8mm～88mm 幅 紙及びエンボステーピングリールΦ 180～330mm ・トレイ (L 335mm × W 230mm × H 25mm)

II 基板の仕様

サイズ	Min50×50mm ～ Max610×460mm(条件付き)、t 0.3～4.0mm
実装エリア	上下端面より3.0mmのエリアには 部品及び認識マーク配置不可
材質	ガラエポ(FR4、CEM3等)その他については条件の検討が必要 FPCも実装可能、但し搬送用パレットの作成が必要
表面処理	耐熱フラックス処理、Auフラッシュ処理、半田レベラー処理に対応
認識マーク	・形状 → ○□◇△ 等 ・サイズ → 0.5～2.0mm (Φ 1.0mmの○が推奨) ・基板の対角に2点以上配置、基板と認識マークには一定のコントラストが必要 また認識マークの背景にはそのマークと異なる0.2mm以上の不干渉エリアが必要
バッドマーク	Φ 3.0mm以上 または□ 3.0mm 以上のマーク 複数枚綴りの基板の場合、綴り枚数分のバッドマークが必要 不良ブロックのマークをマーク色とコントラストのできる色で塗るか 50μ m以下の厚みのPETテープを貼り付ける
部品配置	部品隣接間0.25mmの配置でも実装可能(0603チップ)

III 試作に必要な資料

基板データ	メタルマスク用ガーバーデータ及び確認用データ (HPGL、DXFファイル) 部品配置図 (HPGL、DXFファイル)、実装部品XY座標リスト (TXTファイル)
部品リスト	どのリファレンス(ロケーション)にどんな部品を実装するのか明記されたリスト(Excel)
試作指示書	どのような内容の試作をどのような条件で行うのか明記されたもの(メールでも可)
リフロー条件	使用半田、プリヒート～リフローの温度・時間条件と大気・窒素(N2)雰囲気指定

その他の仕様に関しましても一度ご相談下さい。



0120 - 976 - 634



メールによるお問合せはこちらから

受付時間 9:00～12:00、13:00～17:00 (土日祝日を除く)